



後工程工場の統廃合について

日本スパンション

November , 2011



2011年3Q決算報告

CONFIDENTIAL

Historical Financial Summary: Proforma

(for illustrative purposes)

US\$ in Millions	3Q10	Q410	Q111	Q211	Q311
Net Sales	320	330	294	299	258
COGS	206	208	189	190	165
Gross Margin	114	123	105	109	93
R&D	26	25	29	25	21
SG&A	37	33	34	34	26
Adjusted Operating Income ¹	51	64	43	50	47
Adjusted EBITDA ²	79	92	71	79	69
% of Sales					
Gross Margin	35.6%	37.1%	35.8%	36.6%	36.2%
Adjusted EBITDA Margin	24.7%	27.8%	24.2%	26.3%	26.8%
R&D	8.0%	7.6%	9.7%	8.4%	8.0%
SG&A	11.6%	10.1%	11.5%	11.5%	10.1%
Op Inc	16.0%	19.4%	14.6%	16.7%	18.1%

Note 1: Adjusted Operating Income presented here further excludes restructuring charges, asset impairment charges, Samsung litigation expenses or credits, stock based compensation and non recurring items.

Note 2: Adjusted EBITDA is a non-GAAP financial measure and for purposes of this presentation, it is GAAP net income that is adjusted for the impact of (i) interest, (ii) taxes, (iii) depreciation and amortization, and further adjusted for (iv) fresh start accounting adjustment, (v) stock-based compensation

Balance Sheet Trend

US\$ in Millions	Q310	Q410	Q111	Q211	Q311
Cash, Cash Equivalents and ST Investments ¹	330	354	308	314	301
Account Receivable	148	166	158	130	106
Inventory	181	169	178	175	211
Account Payable	104	119	97	96	105
Debt	458	455	453	448	450
Debt net of Cash ¹	128	101	144	134	149
<i>DPO</i>	30	34	37	36	47
<i>DSO</i>	44	46	49	40	37
<i>DOI</i>	59	59	72	72	104

Note 1: Cash balance included T-bills with maturity terms more than 90 days & ARS

2011年4Qのリストラ概要

- 全世界で20%の人員削減を実施
 - 後工程工場の統廃合、KL工場のBKK工場への集約
 - 全部門・全拠点で10%～20%の人員削減を実施（日本：10%強）
- 財務への影響
 - リストラ費用: \$30M～\$56M （Q411: \$18M～\$44M; Q112, ～\$6M; Q212, ～\$3M; Q312, ～\$2M）
 - Cash: ～\$24M, Non-cash: \$6M～\$32M
- リストラに伴う年間経費削減効果: - \$30M
- NOR Market Dynamics (WSTS)

	Q2	Q3	Delta	% Chg
Americas	\$ 69,498	\$ 46,524	\$ (22,974)	-33%
EMEA	\$ 121,884	\$ 119,469	\$ (2,415)	-2%
Japan	\$ 194,095	\$ 161,384	\$ (32,711)	-17%
APAC	\$ 728,287	\$ 528,763	\$ (199,524)	-27%
Total	\$ 1,111,764	\$ 854,140	\$ (257,624)	-23%



Kuala Lumpur工場閉鎖について

CONFIDENTIAL

工場統合の背景

- 世界的な景気低迷に伴う需要の減少により、春頃よりBKK/KL工場の稼働率が低下。夏以降、欧州の財政危機を発端とする欧米景気と中国市場の減速により、工場稼働率が更に悪化
 - BKK工場 稼働率60% → 40% (1Q12)
 - KL工場 稼働率50% → 30% (1Q12)
- 工場稼働率の低下が、当社損益を著しく悪化させ、赤字転落の危機に直面
- 2012年前半も景気低迷が続くと判断
- Chapter 11の苦い経験から、財務状況健全化・損益改善のためには、工場統合が必要という経営判断が、早い段階で下された

BKK工場に統合が決定された背景

- BKK工場は、もともと、BGA, MCP, TSOP全てを生産できる工場であり、既にTSOPの設備も持っていることから、工場移管は設備上も製造の観点からも全く問題がない
- 一方、KL工場は大半がTSOPの設備で、特に試験設備がBKK工場と比較し、大幅に劣っている
- BKK工場の方が、敷地も広く、将来的な拡張性が高い
- BKK工場はタイ政府からもAwardを受けており、工場としてもKL工場よりも新しい工場
- BKK工場に統合した後も、稼働率は70%～80%であり、製造設備・能力面で十分対応が可能

Bangkok工場とKL工場の比較

		Bangkok	Kuala-Lumpur	Remarks
Assembly	TSOP 48	Y	Y	
	TSOP 56	Y	Y	BKK Previously qualified
	FBGA	Y	Y	
	MCP	Y		Critical Capability
	Legacy AMD	Y	Y	
	Legacy MBM		Y	EOL
	SO44	Y		
	SSOP56		Y	EOL
Test				
	TSOP	Y	Y	
	FBGA	Y	Y	
	SSOP56	Y	Y	
	MCP	Y		
	SPI	Y		
	PQR	Y		
	PL32	Y		
	SO44	Y		



KL工場からBKK工場への移管設備

- 組立装置移管予定
 - TSOP56用の全設備
 - TSOP48用の1ライン
 - 銅ワイヤ関連の装置
- 試験装置移管予定
 - 28台のテスターをKLからBKKに移管予定

Bangkok工場のBack-up

- Assembly sites high volume packages

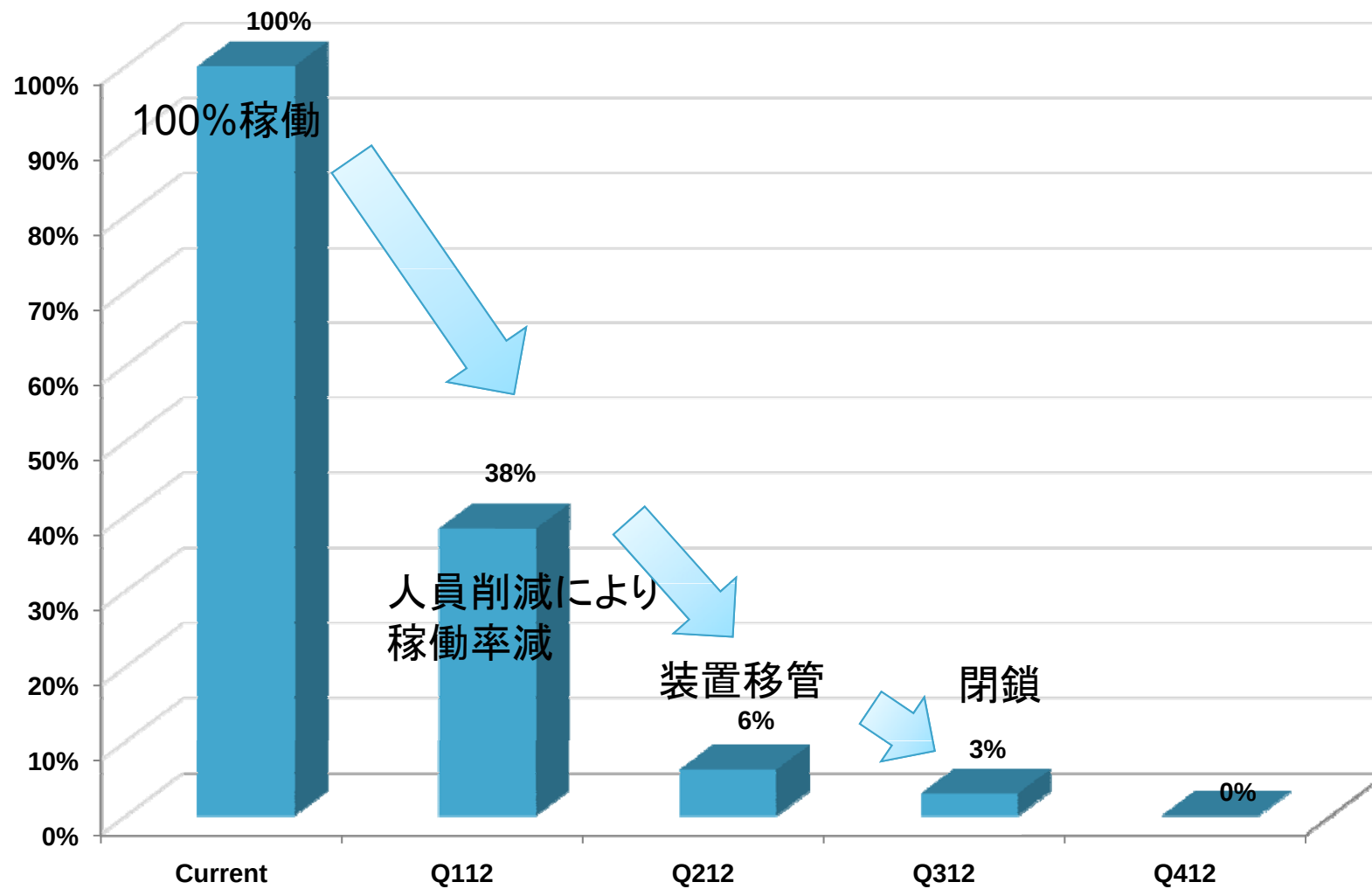
Package	Primary	Secondary
LAA064	BKK	ChipMos
SOC008	UTL	ChipMos
SO3016	ASE	UTL
TSOP048	BKK	ChipMos
TSOP056	BKK	ChipMos
VBK048	BKK	ChipMos

- Test sites high volume packages

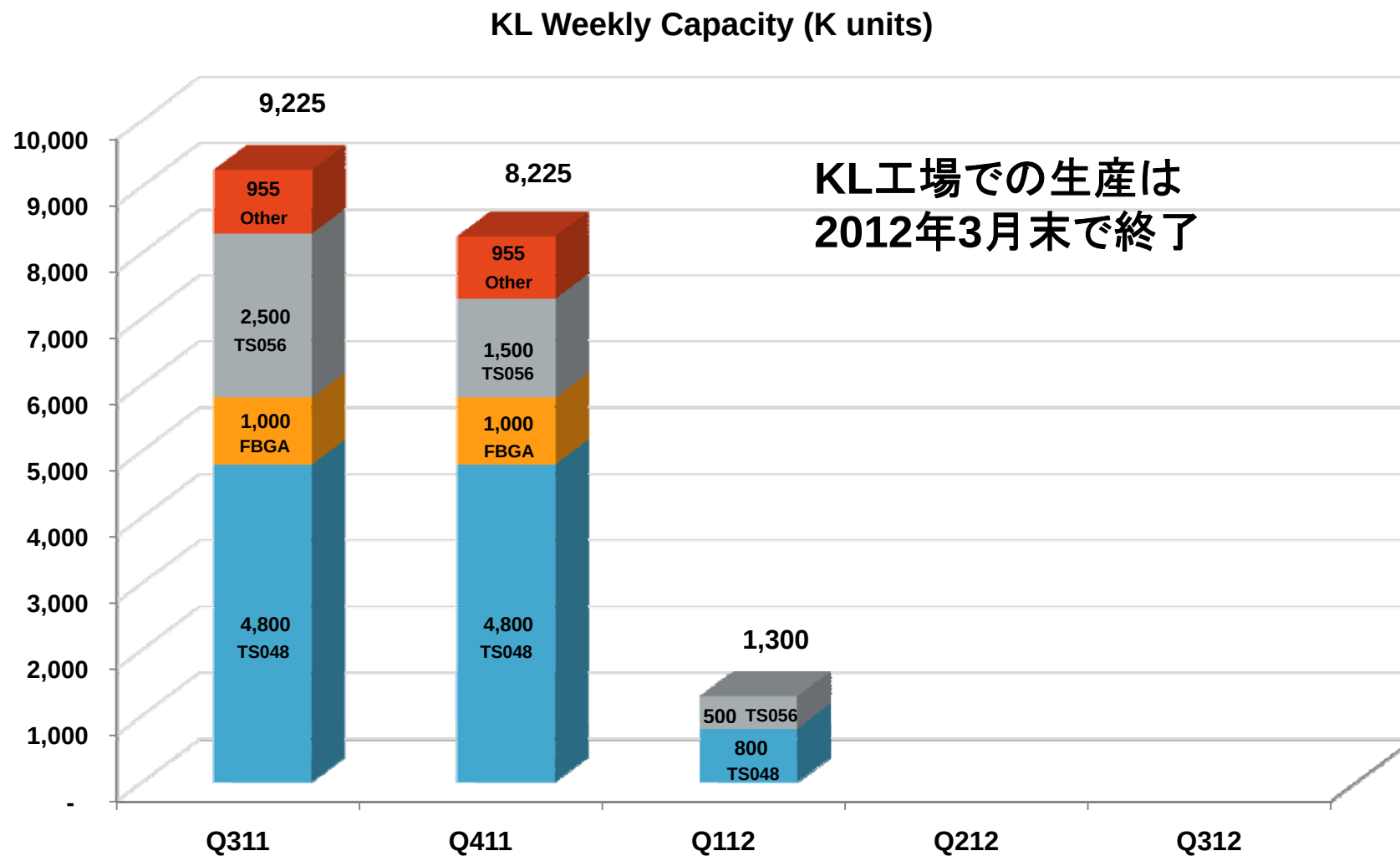
Package	Primary	Secondary
LAA064	BKK	ChipMos
SOC008	BKK	TBD
SO3016	BKK	TBD
TSOP048	BKK	ChipMos
TSOP056	BKK	ChipMos
VBK048	BKK	ChipMos



KL工場の人員削減予定



KL工場の閉鎖までの製造予定

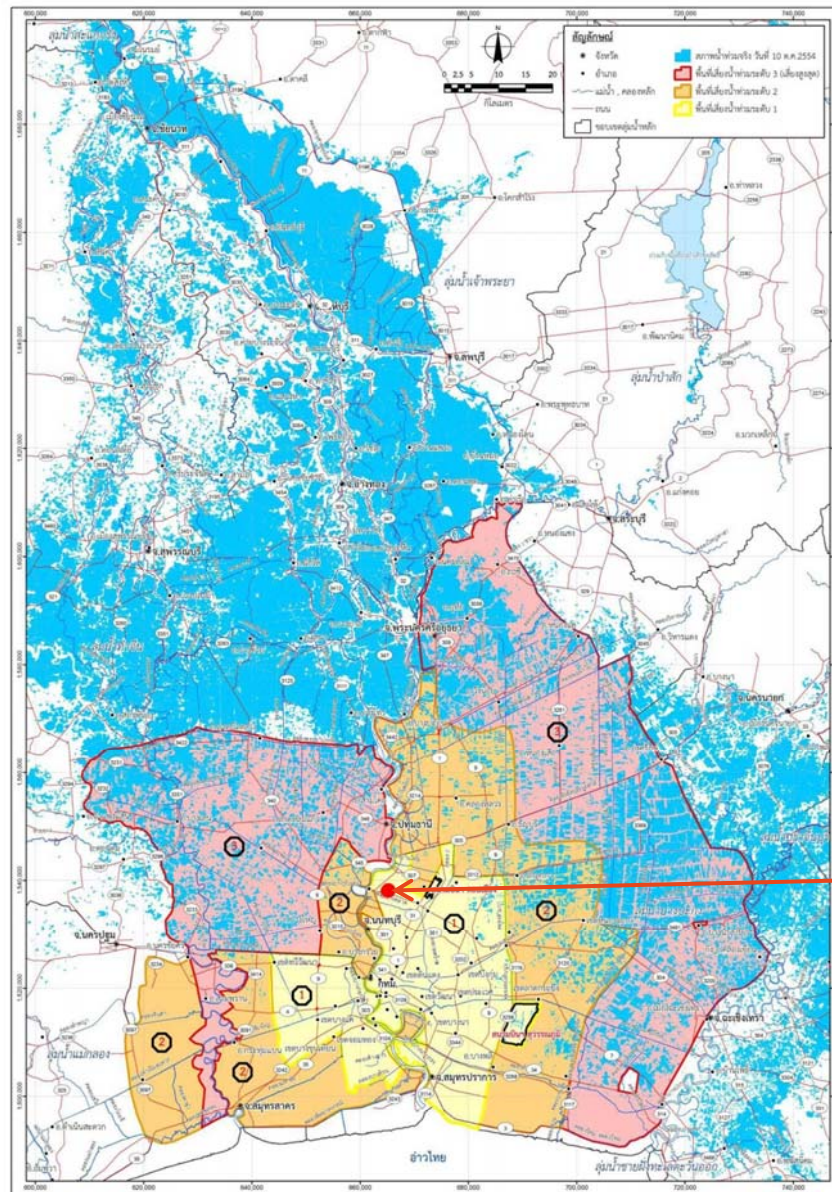




Bangkok工場の状況・洪水対策

CONFIDENTIAL

洪水リスク区域



洪水エリア

リスクレベル 3

危険リスク: 洪水水位1~2メートルが1~2か月続く区域。

リスクレベル 2

高リスク: 洪水水位1~2メートルが1~2か月続く区域。

リスクレベル 1

中リスク: 洪水水位が0.5メートル以下の区域。

Spancion Thailand 社はリスクレベル1区域に位置しています。

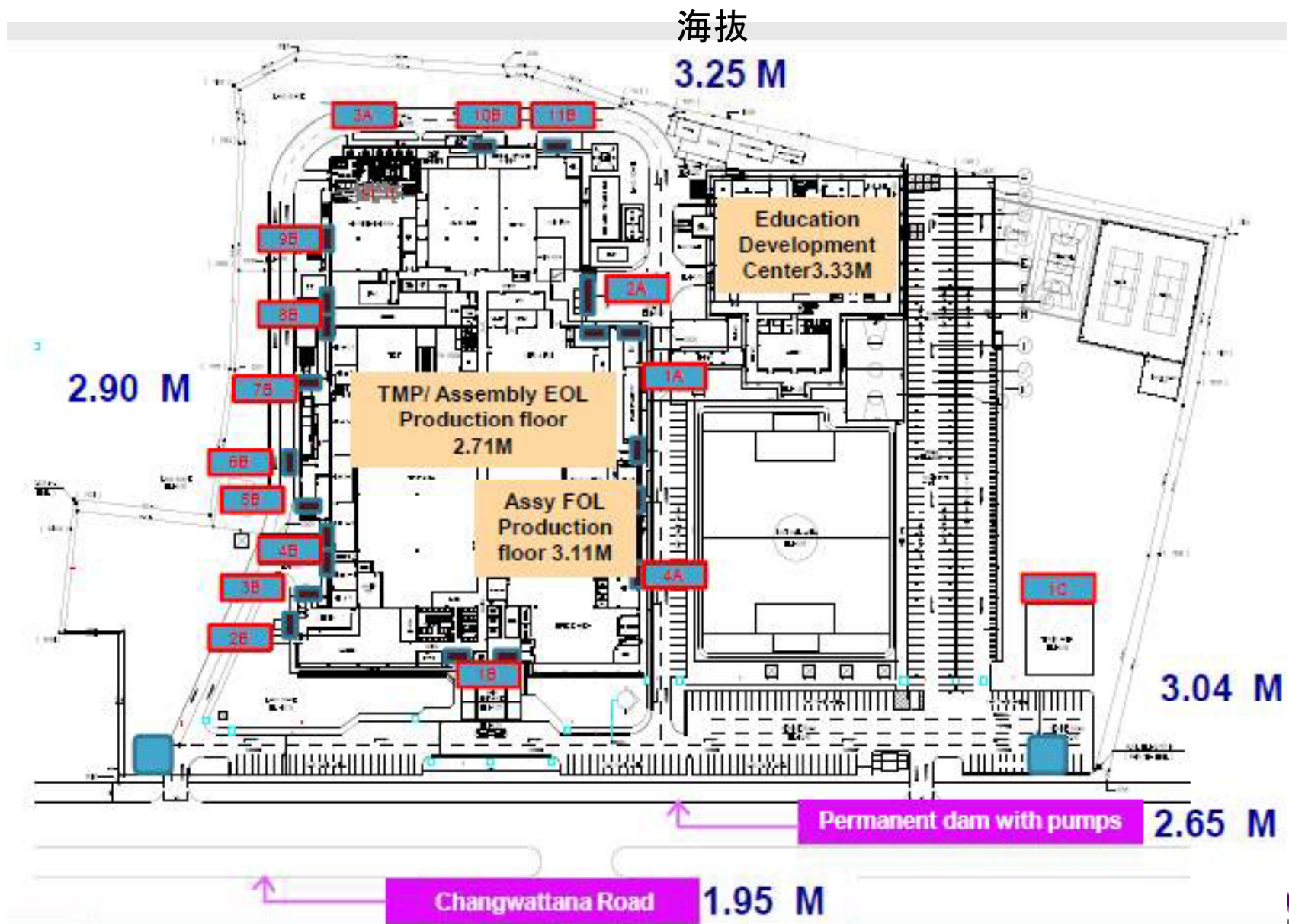
Spancion BKK工場所在地



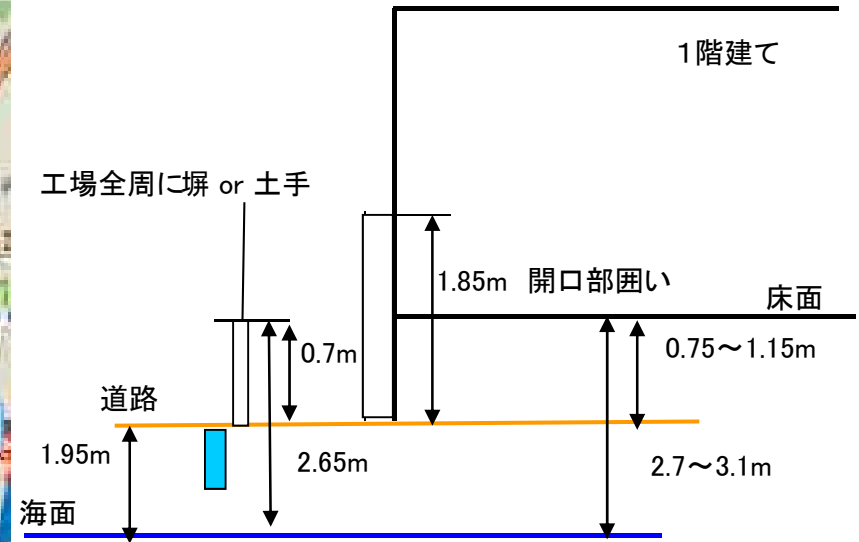
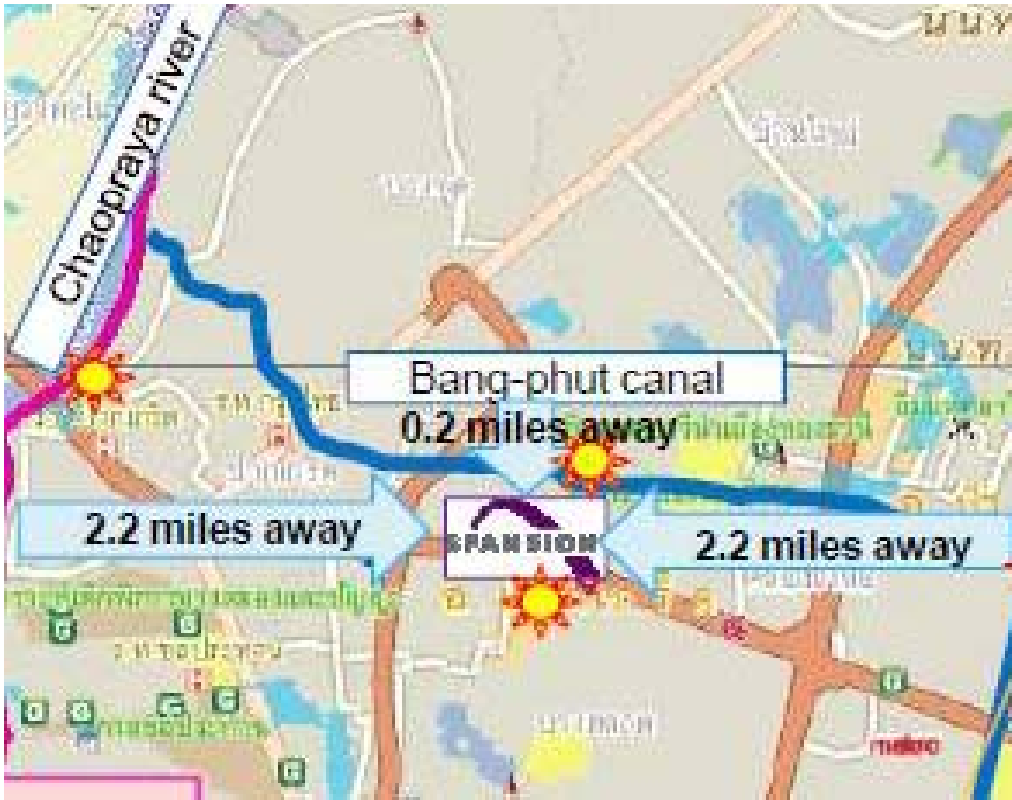
Spansion Thailand 周边状况



Spancion Thailand敷地

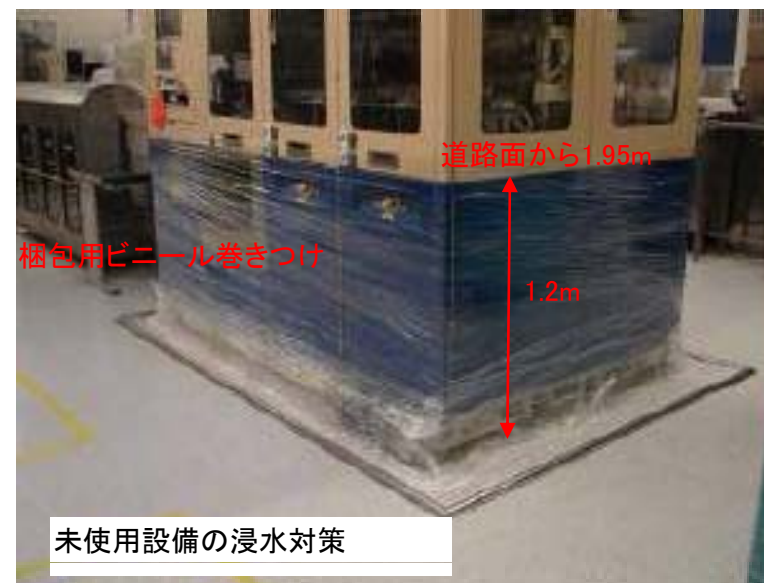


Spanstion Thailandの周辺状況と地理的概況



敷地内浸水時	道路より1.85m で建屋内浸水防止	
建屋内浸水時	道路より0.8m で設備下分冠水	
	道路より1.35～1.45m で在庫品冠水	

Spancion Thailand洪水対策



工場内通路の浸水対策





www.spansion.com

Spancion®, the Spancion logo, MirrorBit®, MirrorBit® Eclipse™ and combinations thereof are trademarks and registered trademarks of Spancion LLC in the United States and other countries. Other names used are for informational purposes only and may be trademarks of their respective owners.

This document is for informational purposes only and subject to change without notice. Spancion does not represent that it is complete, accurate or up-to-date; it is provided "AS IS." To the maximum extent permitted by law, Spancion disclaims any liability for loss or damages arising from use of or reliance on this document.